

# 目 次

見本

このPDFは、CQ出版社発売の「実用マイクロ波技術講座 -集積回路と応用-第6巻」の一部分の見本です。内容・購入方法などにつきましては是非以下のホームページをご覧下さい。  
<http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/79/79761.htm>

## 第1章 マイクロ波半導体回路とデバイスの概要

1.1	RF フロントエンド回路の構成 .....	9
1.1.1	携帯電話システムの通信方式 .....	9
1.1.2	RF フロントエンドの一般的構成 .....	11
1.1.3	RF-IC の小型化、低コスト化、多機能化 .....	12
1.1.4	ダイレクトコンバージョン方式 .....	14
1.2	マイクロ波半導体デバイスの特長 .....	16
1.2.1	電界効果トランジスタ (MESFET) .....	16
1.2.2	高移動度トランジスタ (HEMT) .....	20
1.2.3	Si パワーMOSFET .....	24
1.2.4	ヘテロ接合バイポーラトランジスタ (HBT) .....	25
1.2.5	マイクロ波デバイスの比較 .....	32
1.3	基本回路の性能評価尺度 .....	33
1.3.1	受信フロントエンド .....	33
1.3.2	送信フロントエンド .....	37

## 第2章 マイクロ波受動回路とその応用

2.1	多層基板を応用したセラミック部品と集積回路 .....	43
2.1.1	セラミック多層基板とパッシブ・インテグレーション .....	44
2.1.2	携帯電話の高周波回路ブロック・ダイヤグラム .....	49
2.1.3	セラミック多層基板を応用した受動部品 .....	50
2.1.4	パッシブ・インテグレーションの具体例 ～フロントエンドモジュール .....	56

# 見本

## 2.1.5 アクティブ素用例

～パワーアンプモジュール ..... 58

2.1.6 モデリング及びシミュレーション技術 ..... 60

2.2 誘電体フィルタおよびSAWフィルタ ..... 61

2.2.1 各種フィルタの方式別棲み分けについて ..... 61

2.2.2 誘電体フィルタの鉛フリー化対応について ..... 61

2.2.3 平衡入出力タイプについて ..... 63

2.2.4 高周波化（準ミリ波、ミリ波への対応：

TEMモード $\lambda/4$ 共振器からの脱皮) ..... 64

2.2.5 弹性表面波デバイス ..... 65

2.2.6 弹性表面波の特徴と主な材料 ..... 65

2.2.7 素子構造 ..... 67

2.2.8 SAWフィルタの周波数特性 ..... 68

2.3 サーキュレータ・アイソレータ ..... 71

2.3.1 積層技術を応用したサーキュレータ ..... 71

2.3.2 固有値理論による集中定数型サーキュレータの設計 ..... 72

2.3.3 サーキュレータの固有値測定法 ..... 74

2.3.4 積層技術による閉磁路サーキュレータの製造 ..... 78

## 第3章 携帯電話用高出力デバイス

3.1 携帯電話端末用デバイス ..... 84

3.1.1 HBTパワーアンプモジュール ..... 86

3.1.2 HJFETパワーアンプモジュール ..... 94

3.2 携帯電話基地局用デバイス ..... 104

3.2.1 W-CDMA基地局用HJFETパワーアンプモジュール ..... 105

3.3 まとめと今後の展開 ..... 110

**見本****第4章 マイクロ波 LAN**

4.1	5GHz 帯システムにおける高周波デバイス .....	113
4.1.1	ETC システムの概要 .....	113
4.1.2	無線高周波部構成 .....	114
4.1.3	5GHz 帯高周波回路技術 .....	115
4.2	Bluetooth における高周波デバイス .....	125
4.2.1	Bluetooth システムの概要 .....	125
4.2.2	Bluetooth の無線高周波部構成 .....	128

**第5章 Si-MMIC とその応用**

5.1	Si-MMIC の特徴と課題 .....	137
5.2	Si-MMIC プロセスの現状と動向 .....	138
5.2.1	Si-MMIC プロセスの種類とその特徴 .....	138
5.2.2	SiGe プロセス .....	140
5.2.3	CMOS プロセス .....	141
5.2.4	基板変更によるトランジスタの高周波化 .....	142
5.3	受動回路素子の低損失化 .....	145
5.3.1	伝送線路 .....	146
5.3.2	オンチップ受動回路素子 .....	151
5.4	Si-MMIC の開発例 .....	154
5.4.1	SiGe-MMIC .....	154
5.4.2	CMOS-MMIC .....	157
5.4.3	オンチップ整合 Si-MMIC の実用例 .....	158
5.5	むすび .....	160

**見本****第6章 ミリ波帯 MMIC とシステム応用**

6.1	ミリ波帯 MMIC .....	165
6.1.1	ミリ波帯デバイスの測定 .....	165
6.1.2	ミリ波帯デバイスの等価回路モデル .....	169
6.1.3	Ku/Ka/V/W 帯 MMIC 増幅器 .....	172
6.2	ミリ波帯 MMIC モジュール .....	174
6.2.1	モジュール設計のポイント .....	174
6.2.2	Ku/Ka/V/W 帯 MMIC モジュールへの応用例 .....	177
6.2.3	ミリ波帯 MMIC モジュール実装技術 .....	178
	索引 .....	183

※本シリーズは5巻まで通しの章立てとなっていますが、6巻からは  
応用編となるためカバーの色を変えるのと併せ各巻ごとの章立てと  
します。